## -' First Hit

# Generate Collection Print

L29: Entry 23 of 28

File: JPAB

Dec 4, 1998

PUB-NO: JP410319221A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10319221 A

TITLE: OPTICAL ELEMENT AND PRODUCTION THEREOF

PUBN-DATE: December 4, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

YAMADA, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RICOH CO LTD

APPL-NO: JP09139442 APPL-DATE: May 14, 1997

INT-CL (IPC): G02 B 5/18; B23 K 26/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a completely dried diffraction grating end optical element by a high speed processing by irradiating a polymeric material having a reflection film and processible with laser ablation with a beam of laser from a direction of the reflection film and making a diffraction grating form of the reflection film.

SOLUTION: A beam of laser oscillated from a laser device 1 is transmitted by being reflected by a total reflection mirror 2, etc., and is adjusted in the intensity and uniformed to be emitted onto a mask 4. An optical system is comprised of such a mechanism as an intensity distribution of the mask is fixed by a projection lens 5 and a processed piece 6 with a reflection film is fixed on a stage 7 adjustable in the direction of an optical axis, and a pattern is continuously formed by moving the stage 7, if necessary. And, a reflection film is added onto an ablative film. This film with the reflection film is irradiated with laser beam. A part of the irradiated laser beam transmits the reflection film and the polymeric material is irradiated the laser beam. Thus, this polymeric material is ablated and also the reflection film is removed, and a diffraction grating is formed.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平10-319221

(43)公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) Int.CL.6

識別記号

ΡI

G 0 2 B 5/18 B 2 3 K 26/00 G 0 2 B 5/18

B 2 3 K 26/00

Δ

## 審査請求 未請求 請求項の数15 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-139442

(71)出題人 000006747

株式会社リコー

平成9年(1997)5月14日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 山田 ▲泰▼史

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

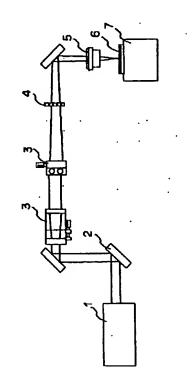
会社リコー内

### (54) 【発明の名称】 光学素子及び光学素子の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 完全ドライ化された回折格子や光学素子の高速加工製造方法及び上記製造法で作成された、溝形状を有する光学素子を提供する。

【解決手段】 格子形状のマスクの投影照射可能な光学 系を有するレーザアブレーション加工部 1~5によって、少なくとも一部に反射膜を有するレーザアブレーション加工可能な高分子材料からなる被加工材 6 に反射膜 方向からレーザを照射し、反射膜の回析格子形状を作成する。



インリング を受けませる イング な多アンズ 区の発展力を放び工人 を参えアーン

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 格子形状のマスクの投影照射可能な光学 系を有するレーザアブレーション加工装置によって、少 なくとも一部に反射膜を有するレーザアブレーション加 工可能な高分子材料に反射膜方向からレーザを照射し反 射膜の回析格子形状を作成することを特徴とする光学素 子製造方法。

【請求項2】 レーザ装置とレーザ光を任意の位置に照 射する手段あるいは基板を任意の位置に平行移動させ得 る手段から構成されるレーザ加工装置によって少なくと 10 も一部に反射膜を有するレーザアブレーション加工可能 な材料に反射膜方向からレーザを照射し光あるいは基板 を連続的に移動し、回析格子形状を作成することを特徴 とする光学素子製造方法。

【請求項3】 紫外域の波長を出力するレーザと、同波 長での透過率が高い反射膜材料を用いることを特徴とす る請求項1または請求項2記載の光学素子製造方法。

【請求項4】 反射薄膜による透過光のエネルギーがレ ーザアブレーション閾値以上の領域で調整可能なレーザ 装置によってレーザ光の出力を調整しながら加工を行う 20 れてきた。また反射、透過量を空間的に制御出来るた ことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載 の光学素子製造方法。

【請求項5】 倍率調整手段と基板の平行移動手段を有 する請求項1または請求項3記載の光学素子製造方法。

【請求項6】 立体形状をした被加工材料と同材料を光 軸方向へ移動する手段を有する請求項1または請求項2 記載の光学素子製造方法。

【請求項7】 ガラス基板と反射膜の中間にレーザアブ レーション加工可能な高分子薄膜層を形成した材料を用 学素子製造方法。

【請求項8】 請求項1または請求項2に記載の手段に よって作成された回析格子形状を有する高分子フィル

【請求項9】 接着剤により前記請求項8記載の高分子 フィルムを付加して構成し、あるいは少なくとも一部に 粘着層あるいは接着層が設けられた前記請求項8記載の 高分子フィルムを付加して構成したことを特徴とする構 造体。

【請求項10】 少なくとも一部が球面であり、請求項 40 1または請求項2記載の手段によって作成された溝形状 を備え、あるいは上記溝形状を有する高分子膜を付加し て構成したことを特徴とする構造体。

【請求項11】 少なくとも一部が立体形状であり、請 求項6記載の手段によって作成されたことを特徴とする 高分子構造体。

【請求項12】 高吸収係数の材料あるいは吸光材料を 分散させた材料からなることを特徴とする請求項8記載 の高分子フィルム。

【請求項13】 前記高分子膜は請求項8記載の回析格 50 【0005】

子形状を有し、かつ高吸収係数の材料あるいは吸光材料 を分散させた材料からなることを特徴とする請求項10 記載の構造体。

【請求項14】 少なくとも一部が透明である高分子上 に反射膜溝形状を有することを特徴とする請求項8記載 の高分子フィルム。

【請求項15】 前記高分子膜は少なくとも一部が透明 である高分子上に反射膜溝形状を有することを特徴とす る請求項10記載の構造体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザアブレーシ ョンによる分光、単色化のための回折格子、位置決め制 御用エンコーダスケール等を含む各種光学素子の製造 法、ならびに上記製造法により作成された光学素子に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】光学素子の1つである回折格子は波長選 択性を有するため分光器等の波長分散素子として用いら め、各種光学素子として用いられている。またエンコー ダ用スケールはモータ制御ステージの高精度位置決めの ため、近年特に重要性が増し利用が進んでいる。

【0003】これら回折格子、スケールはこれまで主に 機械加工、フォトファブリケーション、干渉露光法、イ オン・電子ビーム描画法で作成されている。機械加工で は、ベースとなる基板表面に回折格子の溝形状を作成 し、基板全面にわたって連続的に溝形状を形成する方法 である。フォトファブリケーションは基板表面に塗布し いることを特徴とする請求項1または請求項2記載の光 30 たレジスト膜をマスク露光によりパタン化し、エッチン グにより基板の溝形状を形成する方法である。干渉露光 法はレジスト膜を2光東光干渉露光法によりパタン化 し、エッチングを施す等して満形状を形成する方法であ る。イオン・電子ビーム直描法はエネルギービームを空 間的に制御して基板上を照射することで溝形状を形成す る方法である。

> 【0004】またレーザアブレーション加工はレジスト ワークを必要としない直接加工法として研究されている 手法であり高分子を中心とする材料の微細加工法とし て、あるいは飛散物質による薄膜形成法として注目され ている。アブレーションを利用した回折格子製造法とし ては、特開平7-027910号公報、あるいは特開平 8-1847078公報で開示されたものがある。前者 手法ではレーザ光を直接基板に照射し基板のアブレーシ ョン作用により溝形状を形成する。後者ではレーザアブ レーションによるフラグメントをマスクを通して基板に 衝突させることで格子を形成する方法である。上記回折 格子は通常ガラス基板等に作成され、平面ガラス上の金 属膜、レジスト膜、樹脂膜等で溝形状が形成される。

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記機械加工では、微小な回折格子の溝形状を精度良くかつ再現性良く作成することは困難であった。フォトファブリケーションによる方法ではレジスト塗布、乾燥、現像、エッチング等多くの工程を必要とし溝形状の制御は困難で、断面形状に制限があった。

【0006】干渉露光法では加工装置の振動の影響除去やアライメント等専門的知識が必要で、被加工材料も高分子性フォトレジストや2P樹脂等に制限され、選択幅が狭い。またこの場合も加工形状の制御が困難で、形状 10変化をおこしやすい問題があった。

【0007】さらにフォトファブリケーション、干渉露 光法では、レジスト塗布等のウエット工程が含まれ、不 純物混入や洗浄工程を要求される問題があり、基板材料 が平面でない場合には対応が出来なかった。

【0008】電子・イオンビームによる製造法では、大型真空系を要する事や電子・イオンビーム源が高価である点などから加工コストが高い問題があり、加工速度も遅く長尺スケールを作成するのが困難であった。

【0009】レーザアブレーションによる製造法では、 基板材料を直接加工している。レーザアブレーションでは金属材料の除去加工には大きなエネルギーが必要で、 形状の制御が困難である。ガラス、セラミック材料の場合も大きなレーザエネルギーが必要で生産性が高くなく、縮小投影加工は困難である。またこれは単一材料に 対する加工法であり、反射率の制御や溝形状の制御が単一材料の特性に支配される問題があった。またアブレーションではレーザ光の1照射あたりの加工深さの制御が 困難で、同一形状の格子の作成が困難であった。

【0010】またこれら製造法は、通常平面度の高いが 30 ラス基板等の平面構造材料上に回折格子やスケール等の 光学素子を作成するもので、球面を有する面上への溝形 状は困難であった。また回折格子を他の材料へ付加する 場合、回転する面や伸び変形する材料上への付加は困難 であった。

【0011】また反射により信号を制御するためには、 ガラス基板の裏面に光吸収する材料を付加する必要があ り、この場合反射が表面と裏面でおきるため基板材料の 影響を受ける問題があった。また基板材料の選択性が低 いため高価な基板材料を使う必要があり、素子への付加 40 材料や素子を接着するための接着材料の制限も多い問題 があった。

【0012】本発明は前記のような従来技術の課題や欠点を解決するためなされたもので、完全ドライ化された回折格子や光学素子の高速加工製造方法及び上記製造法で作成された、溝形状を有する光学素子を提供することを目的とする。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】前記課題を実現するため 本発明の請求項1に係る光学素子製造方法は、格子形状 50

のマスクの投影照射可能な光学系を有するレーザアブレーション加工装置によって、少なくとも一部に反射膜を有するレーザアブレーション加工可能な高分子材料に反射膜方向からレーザを照射し反射膜の回析格子形状を作成することを特徴とする。

【0014】本発明の請求項2に係る光学素子製造方法は、レーザ装置とレーザ光を任意の位置に照射する手段あるいは基板を任意の位置に平行移動させ得る手段から構成されるレーザ加工装置によって少なくとも一部に反射膜を有するレーザアブレーション加工可能な材料に反射膜方向からレーザを照射し光あるいは基板を連続的に移動し、回析格子形状を作成することを特徴とする。

【0015】本発明の請求項3に係る光学素子製造方法は、請求項1または2記載の光学素子製造方法において 紫外域の波長を出力するレーザと、同波長での透過率が 高い反射膜材料を用いることを特徴とする。

【0016】本発明の請求項4に係る光学素子製造方法は、請求項1~3いずれかに記載の光学素子製造方法において反射薄膜による透過光のエネルギーがレーザアブ20 レーション関値以上の領域で調整可能なレーザ装置によってレーザ光の出力を調整しながら加工を行うことを特徴とする。

【0017】本発明の請求項5に係る光学素子製造方法 は、請求項1または3記載の光学素子製造方法において 倍率調整手段と基板の平行移動手段を有することを特徴 とする。

【0018】本発明の請求項6に係る光学素子製造方法 は、請求項1または2記載の光学素子製造方法において 立体形状をした被加工材料と同材料を光軸方向へ移動す る手段を有することを特徴とする。

【0019】本発明の請求項7に係る光学素子製造方法は、請求項1または2記載の光学素子製造方法においてガラス基板と反射膜の中間にレーザアブレーション加工可能な高分子薄膜層を形成した材料を用いることを特徴とする。

【0020】本発明の請求項8に係る高分子フィルムは、請求項1または2に記載の手段によって作成された回析格子形状を有することを特徴とする。

【0021】本発明の請求項9に係る高分子フィルムを付加した構造体は、接着剤により前記請求項8記載の高分子フィルムを付加して構成し、あるいは少なくとも一部に粘着層あるいは接着層が設けられた前記請求項8記載の高分子フィルムを付加して構成したことを特徴とする。

【0022】本発明の請求項10に係る構造体は、少なくとも一部が球面であり、請求項1または請求項2記載の手段によって作成された溝形状を備え、あるいは上記溝形状を有する高分子膜を付加して構成したことを特徴とする。

) 【0023】本発明の請求項11に係る高分子構造体

は、少なくとも一部が立体形状であり、請求項6記載の 手段によって作成されたことを特徴とする。

【0024】本発明の請求項12に係る高分子フィルム は、請求項8記載の高分子フィルムであって、高吸収係 数の材料あるいは吸光材料を分散させた材料からなるこ とを特徴とする。また本発明の請求項13に係る構造体 は、請求項10記載の構造体において、前記高分子膜は 請求項8記載の回析格子形状を有し、かつ高吸収係数の 材料あるいは吸光材料を分散させた材料からなることを 特徴とする。

【0025】本発明の請求項14に係る高分子フィルム は、請求項8記載の高分子フィルムであって、少なくと も一部が透明である高分子上に反射膜溝形状を有するこ とを特徴とする。また本発明の請求項15に係る構造体 は、請求項10記載の構造体であって、前記高分子膜は 少なくとも一部が透明である高分子上に反射膜溝形状を 有することを特徴とする。

【0026】前記のような本発明に係る構成によって、 照射されたレーザ光が被加工材料上の反射膜を透過して ン作用により、高分子材料の分子レベルでの開裂がお き、レーザ照射部分が外部に飛散する。このとき外部に 飛散する物質はその上部の反射膜も同時に飛散させるた め、照射部全域の加工が行われる。

【0027】また、被加工物を平行移動することで、連 続した形状加工がなされる。

【0028】さらにレーザ光を走査する場合は、直接描 画するためマスクなしで任意の形状の加工がなされ、ま た同時に被加工物を平行移動することで大面積、長尺の 光学素子の加工がなされる。

【0029】また、高分子材料は紫外域に強い吸収があ り、紫外レーザでアブレーション加工可能な材料が多い から、紫外域のレーザを用いることで効率的な加工がな される。また、レーザ強度を調整する手段を用いること で、同一素子上に滞幅の異なる形状形成がなされる。

【0030】また、マスク投影による縮小投影加工の場 合は、マスク位置、投影レンズ、加工位置のいずれか2 つを同時に移動することで加工倍率の選択がなされ、こ れにより倍率の異なる溝形状が形成される。

【0031】また、レーザ照射焦点位置に被加工物の焦 40 点を合わせることで、立体形状をした材料への加工がな され、球面上や段形状をした構造物上への反射形状生成 がなされる。

【0032】さらにレーザアブレーション層を中間に準 備し、レーザ照射によってそれを除去することで、金属 反射膜等の反射薄膜付きガラス基板の加工がなされる。 また、ガラスのアブレーションエネルギー閾値が高分子 より大幅に大きい場合は、加工エネルギーの調節により ガラス面に損傷を与えない加工がなされる。

学機能を有する高分子フィルムは、形状変形が容易であ り、安価かつ機能の選択が容易になる。

【0034】この高分子材料として接着層を付加したフ ィルムが選択されることで、加工後すぐに他の材料へ付 加加工がなされる。

【0035】また、球面を有する材料への光学機能付加 や上記接着材付きフィルムの付加により、球面への光学 機能付加がなされる。

【0036】また、立体形状をした構造体への加工が可 10 能になり、反射膜が立体的に制御された構造物が作成さ ns.

【0037】また、高分子材料の吸収率を高めること で、反射膜と吸収帯とを近接して生成でき、反射率の段 階的な変化や、多階調特性の薄膜光学素子が実現され

【0038】また逆に、透明な高分子を利用すること で、透過型光学素子が実現される。

[0039]

【発明の実施の形態】本発明による製造方法では、レー 高分子材料まで達し、このレーザ光によるアブレーショ 20 ザ光を縮小投影あるいは走査して基板に空間選択的に照 射する工程、基板を3次元に移動する手段と反射膜を有 するアブレーション可能な高分子材料とから構成され る。さらに、高分子の加工特性を高めるため、紫外レー ザと同レーザ光の波長での透過率の高い反射材料から構 成されることが望ましい。

> 【0040】加工溝ピッチを縮小投影倍率により調整す る場合にはマスク、レンズ、加工基板位置のいずれか2 つの平行移動手段から構成される。被加工材料は特に反 射薄膜を付加した高分子材料で構成され、特にガラス基 30 板上に反射膜を形成する場合、基板と反射膜との間にア ブレーション可能な高分子材料の薄膜を形成する。

【0041】また本発明による光学素子は、反射膜の溝 形状を有する形状変形可能な高分子フィルム、球面を有 する構造体、立体形状した高分子構造体、上記フィルム を付加した構造体、のいずれかから構成され、高分子材 料は透明材料、光吸収材料、光吸収材料添加材料のいず れかから構成されることが望ましく、案子を構造体に接 着する場合、接着材料があらかじめ付加された材料が望 ましい。

【0042】以下本発明の実施の形態について説明す

(第1実施形態)図1に、本発明の第1実施形態を示 す. 同図においてレーザ装置1から発振されたレーザ光 は全反射ミラー2等で伝送されながら成形光学系3で強 度調整・均一化されマスク4に照射される。 マスクの強 度分布は投影レンズ5により、反射膜つき被加工物6上 に投影される。反射膜つき被加工物6は光軸方向へ調整 可能なステージ7上に固定され、必要があればステージ 7を移動しパタンを連続的に作成する機構からなる。

【0033】次に、これら製造法によって製造された光 50 【0043】図2に、本発明による光学素子の製造法の

模式図を示す。アブレーション可能なフィルムM1上に 反射膜M2を500~1000オングストローム程度付 加する。 反射膜ン2はCr、A1等の金属膜を蒸着や スパッタ法で付加する方法や色素等を含んだ高分子膜を スピンコート等で作成することが可能である。この反射 膜付きフィルムM1にレーザ光M3を照射する。照射されたレーザ光M3の一部が反射膜M2を透過して高分子 材料M1に照射される。この高分子のアブレーションと ともに反射膜M2が除去され、回折格子M4が形成される。

【0044】(第2実施形態)図3に、本発明の第2実施形態を示す。レーザ装置1から発振されたレーザ光12は全反射ミラー13やオリフィス14等を通して伝送され、集光レンズ15で集光され試料に照射される。レーザ光はガルバノミラー16や移動ステージ17により被加工材料18上に走査される。被加工材料18は前記図2の構成からなり、同様の原理により加工される。レーザ光はレーザ強度を変化させること加工幅を調整することが可能であり、装置内に減光器を設けても同様の作用が可能である。

【0045】(第3実施形態)図4に、本発明の第3実施形態を示す。レーザ装置1から発振されたレーザ光は全反射ミラー2等で伝送されながら成形光学系3で強度調整・均一化されマスク4に照射される。マスクは移動ステージ25上に設置され光軸方向へ移動可能である。また場合によってマスクを回転させる機構やマスクを交換する機構を有する。マスクの像は投影レンズ5を通して移動ステージ7上に固定された被加工材料8表面に照射される。このマスク移動ステージ25と移動ステージ7はステージコントローラ9を通してコンピュータ10に30よって制御される。ステージの移動とレーザ照射数やレーザ照射強度を同時にコンピュータで制御する。これにより、1つのマスクから倍率の異なる形状加工が可能となり、同時にマスク交換、レーザ強度調整を行うことにより様々な形状加工が可能となる。

【0046】(第4実施形態)図5に、ガラス基板上回 折格子作成法の第4実施形態を示す。ガラス基板N1上 に高分子膜N2を付加する。高分子膜N2は0.1μm 程度以下とすると比較的低エネルギーの1回のレーザ光 照射で反射膜N3と高分子膜N2を同時に剥離出来る。 またガラスのレーザアブレーション閾値以下にレーザ強 度を照射することで、ガラス表面N1に影響与えること なく高精度な反射膜形状の作成が出来る。材料は露光に 用いる高分子性レジストのみでなく、光硬化・熱硬化型 樹脂や各種高分子を利用できる。

【0047】(第5実施形態)図6に、本発明による第5実施形態である光学素子の製造法と光学素子を示す。 光学レンズ等球面を有する高分子光学材料P1上にCr、A1等の反射膜P2を付加する。この材料の反射膜上からレーザ光P3を選択的に照射する。これにより反50

射膜P2の溝形状が生成し、この案子に光を照射すると一部が反射され一部が透過する。この時反射光は拡散し、透過光は集光される。このように加工された光学素子P4は、光学的機能を有する。

【0048】(第6実施形態)図7に、本発明による第6実施形態である球面加工による球面を有する光学素子を示す。円柱状の回転する構造体R1上にアブレーション可能な高分子薄膜R2を付加し、さらに反射膜R3を付加する。これにレーザ光R4を部分的に照射し、上記10アブレーション作用により反射膜パタンを形成する。この回転体R1を回転させながらレーザ光R4を順次照射することで、回転体R1表面に反射膜パタンを形成し、表面スケールR5を作成する。このスケールは表面に形成されるため表面の位置制御や速度制御に利用可能となる。これはスケールを作成し、それを回転体に付加することでも達成できる。

【0049】(第7実施形態)図8に、本発明による第7実施形態である立体構造物への反射パタン製造例と製造された光学素子を示す。アブレーション加工可能な高30分子材料を立体的に加工し立体構造体S1とする。立体加工には、機械加工や光造形、アブレーション加工等が利用できる。この材料に反射膜S2をスパッタ、蒸着等で付加し、空間選択的にレーザ光S3を照射する。上記レーザアブレーション作用により例えば図8の平面部のみを加工する。これにより平面部は光が透過し斜面は反射する光学素子S4となる。この素子に信号光S5を照射すると光は部分的に反射され、図のような光反射素子として機能する。

【0050】(第8実施形態)図9に、本発明による第8実施形態である吸収材料を含む光学素子を示す。吸収率を制御した高分子膜T1は多段階に重ねる、あるいは分散量を制御するなどして厚みにより反射率が異なる構造とする。この高分子膜T1上に反射膜T2を付加し、そこにレーザ光T3を照射する。レーザ光T3は強度を制御し、照射量を変える事で加工深さを変え、図9に示す構造体T4とする。この様な構造体T4に光を照射すると図10に示すように位置により信号強度が変化する。これにより段階的な信号を生成する光学素子としての機能を果たす。

【0051】(第9実施形態)図11に、本発明による第9実施形態である透明高分子を用いた光学素子の1実施例を示す。上記手法により高分子薄膜V1上の反射膜V2を、図(A)に示す形状にパタンニングする。さらに同様に(B)、(C)に示す形状加工し光学素子V3を作成する。これらは透明であり、非常に薄くすることも可能であるのでこれらを重ねて図のような複雑な形状のパタン加工が可能となる。この場合(A)、(B)、(C)は同一形状とすることも可能であり、透明であるため透過型の信号処理も可能となる。

0052

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 被加工材料上の反射膜を薄膜とすることで、照射された レーザ光の一部が高分子材料まで達する。このレーザ光 によるアブレーション作用により、高分子材料の分子レ ベルでの開裂がおき、レーザ照射部分が外部に飛散す る。このとき外部に飛散する物質はその上部の反射膜も 同時に飛散させるため、照射部全域の加工が行われる。

【0053】ここで反射膜厚さを薄くする事で、レーザ 光子一個で反射膜の加工が可能であり、レーザ照射時間 可能になる。また反射膜を除去することで反射を制御す るため、深さ方向の加工形状を正確に制御する必要がな く、多くの材料を反射膜、基板材料として利用できる。 【0054】縮小投影加工では、マスクの形状が縮小さ れ、基板の所望の位置に照射される。このような縮小投 影では大面積の形状が一括して行えるため、非常に生産 性が高くなる。

【0055】また、被加工物を平行移動することで、連 続して形状加工することが可能であり、長尺スケールの 作成などが容易に行える。またマスク形状を選択でき、 マスクを交換するなどして溝形状のみでなく様々な反射 形状が作成できる。

【0056】さらにレーザ光を走査する場合は、直接描 画するためマスクなしで任意の形状に加工することが可 能であり、レーザ光を集光して用いるためレーザ出力が 低い場合も利用可能であり、繰り返しレーザやガルバノ ミラー等を用いることで高速に加工を行う事ができる。 また同時に被加工物を平行移動することで大面積、長尺 の光学素子の加工が可能となる。

【0057】通常、高分子材料は紫外域に強い吸収があ 30 り、紫外レーザでアブレーション加工可能な材料が多 い。その為、紫外域のレーザを用いることで効率的な加 工が可能となる。この際、反射材料は赤外から可視域で の反射特性が利用されるため、紫外レーザを用いる場合 その波長域で透過率の高い材料を用いることが好まし

【0058】また、このようなアブレーションのアシス トによる薄膜加工では、レーザエネルギー強度により膜 加工幅が変化する。そのためレーザ強度を調整する手段 を用いることで、同一衆子上に溝幅の異なる形状を容易 40 形成を行うことが可能となる。 に形成可能となる。

【0059】また、マスク投影による縮小投影加工の場 合は、マスク位置、投影レンズ、加工位置のいずれか2 つを同時に移動することで加工倍率を任意に選択するこ とが可能であり、これにより倍率の異なる溝形状を容易 に形成可能となる。

【0060】また、レーザ照射焦点位置に被加工物の焦 点を合わせることで、立体形状をした材料への加工が可 能となり、球面上や段形状をした構造物上への反射形状 生成も可能となる。

【0061】ガラス基板上の金属薄膜加工の場合、レー ザアブレーション層を中間に準備しそれを除去すること で、一般にレーザアブレーションでは加工が困難な金属 反射膜等の反射薄膜付きガラス基板を、低エネルギーで

1.0

高速に加工することが可能となる。またこの除去された 膜の断面形状は、レーザトリミング等の熱加工では得ら れない良好な形状となる。

【0062】また、ガラスのアブレーションエネルギー 閾値が高分子より大幅に大きい場合が多く、このエネル は数ナノ移以下に短縮できるため、非常に高速な加工が 10 ギーで加工することで、ガラス面に損傷を与えない加工 が可能となる。この時同時にガラス面に付着した有機物 を除去する洗浄効果もある。

> 【0063】次に、これら製造法によって製造された光 学機能を有する高分子フィルムは、形状変形が可能であ り安価で脆性が低い特徴を有し、材料の選択性が高く機 能の選択が可能である。

【0064】この高分子材料として接着層を付加したフ ィルムを選択することで、加工後すぐに他の材料へ付加 する事が可能であり、構造剤への光学機能を付加するこ とが出来る。特に高分子の接着剤は選択幅が広く、接着 20 強度、厚み熱特性等を選択する事が容易である。

【0065】また、球面を有する材料への光学機能付加 や上記接着材付きフィルムの付加により困難な球面への 光学機能付加が容易となる。これによりレンズ上へのマ スクや光分岐素子、球面上へのエンコーダ機能作成等が 可能となる。

【0066】また、立体形状をした構造体への加工も可 能であり、反射膜が立体的に制御された構造物が作成で きる。この様な構造体は空間的に光学機能を制御出来る ため、反射分岐素子やマイクロマシン、センサーの一部 に光学機能を付加することが可能となる。

【0067】また、高分子材料の吸収率を高めること で、反射膜と吸収帯とが近接して生成でき反射率を段階 的に変化させたり、多階調の信号が形成される薄膜光学 素子が作成可能となる。また高分子層で光を吸収させる ことで、反射型の案子のN/A をあげる事が出来る。

【0068】また逆に、透明な高分子を利用すること で、ガラスと同様の透過型光学素子としての利用が可能 となり、またこれら素子同士を重ね合わせ、様々な信号

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光学素子製造装置の第一実施形態 における概略図である。

【図2】 本発明の第1実施形態における光学素子製造法 の概略図である。

【図3】本発明の第2実施形態における光学索子製造装 置の概略図である。

【図4】本発明の第3実施形態における光学素子製造装 置の概略図である。

【図5】本発明の第4実施形態における回折格子製造法 50

### の概略図である。

【図6】本発明の第5実施形態における光学索子製造法 及び光学素子の概略図である。

【図7】本発明の第6実施形態における光学素子製造法 及び光学素子の概略図である。

【図8】本発明の第7実施形態における光学素子製造法 及び光学素子の概略図である。

【図9】本発明の第8実施形態における光学索子製造法 及び光学素子の概略図である。

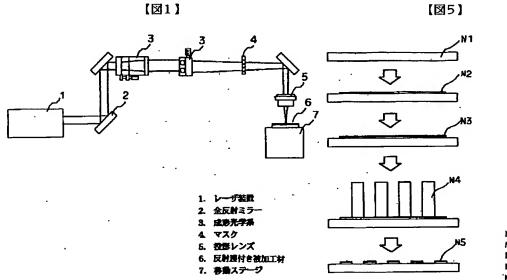
【図10】本発明の第8実施形態における光学素子から 10 7 ステージ の信号例を示す図である。

【図11】本発明の第9実施形態における光学索子製造 法及び光学素子の機略図である。

12

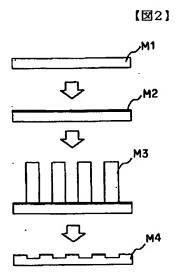
# 【符号の説明】

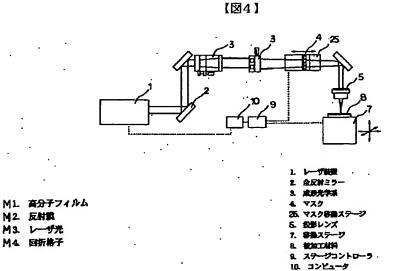
- 1 レーザ装置
- 2 全反射ミラー
- 3 成形光学系
- 4 マスク
- 5 投影レンズ
- 6 反射膜付き被加工材 '

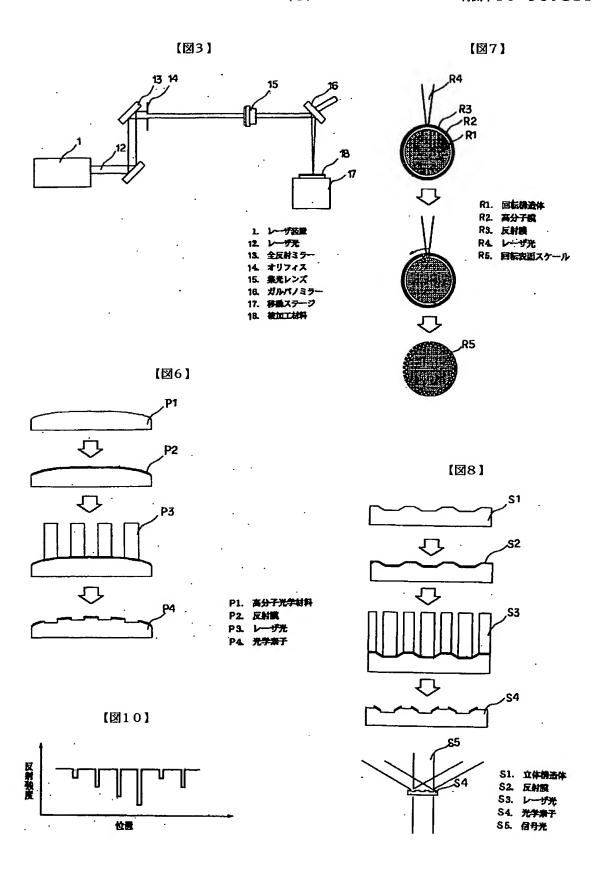


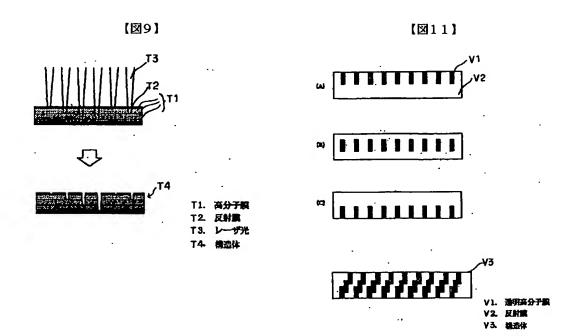
M2. 反射數

N1. ガラス基板 N2 商分子號 N5. 回新格子









#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DETAILED DESCRIPTION**

# [Detailed Description of the Invention]

[The technical field to which invention belongs] This invention relates to the optical element created by the manufacturing method and the above-mentioned manufacturing method of the various optical elements containing the diffraction grating for the spectrum by laser ablation, and monochrome-izing, the encoder scale for point-to-point control, etc. [0002]

[Description of the Prior Art] Since the diffraction grating which is one of the optical elements has wavelength selection nature, it has been used as wavelength dispersion elements, such as a spectroscope. Moreover, since reflection and the amount of transparency are spatially controllable, it is used as various optical elements. Moreover, especially the scale for encoders gains in importance in recent years for high-degree-of-accuracy positioning of a motor control stage, and use is progressing. [0003] These diffraction gratings and a scale are mainly created until now by machining, photofabrication, the interference exposing method, and ion and an electron-beam-lithography method. It is the method of creating the shape of a quirk of a diffraction grating in the substrate surface used as the base in machining, and forming the shape of a quirk continuously over the whole substrate surface. Photofabrication is the method of pattern-izing the resist film applied to the substrate surface by mask exposure, and forming the shape of a quirk of a substrate by etching. The interference exposing method is the method of pattern-izing a resist film by the 2 flux-of-light light interference exposing method, carrying out [ etching etc. and ], and forming the shape of a quirk. Ion and an electron beam straight-writing method are the methods of forming the shape of a quirk by controlling a energy beam spatially and irradiating a substrate top.

[0004] Moreover, laser ablation processing is technique currently studied as a direct processing method which does not need a resist work, and attracts attention as the micro-processing method of the material centering on a macromolecule, or a thin film forming method by the quality of debris. As a diffraction-grating manufacturing method using ablation, there are some which were indicated in JP,7-027910,A or a JP,8-1847078,A official report. By the former technique, a laser beam is irradiated at a direct substrate and the shape of a quirk is formed according to an ablation operation of a substrate. In the latter, it is the method of forming a grid by making the fragmentation by laser ablation collide with a substrate through a mask. The above-mentioned diffraction grating is usually created by the glass substrate etc., and the shape of a quirk is formed by the metal membrane on plane glass, the resist film, a resin film, etc.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, it was difficult to create the shape of a quirk of a minute diffraction grating with repeatability often [precision] and sufficient in the above-mentioned machining. By the method by photofabrication, many production processes, such as resist spreading, desiccation, development, and etching, were needed, quirk-like control was difficult and the cross-section configuration had a limit.

[0006] Expertise, such as effect removal, alignment, etc. of vibration of processing equipment, is required of the interference exposing method, a work material is also restricted to a macromolecule nature photoresist, 2P resin, etc., and selection width of face is narrow. Moreover, also in this case, control of a processing configuration was difficult and there was a problem which is easy to cause configuration change.

[0007] Furthermore, by photofabrication and the interference exposing method, wet production processes, such as resist spreading, were included, there was a problem of which impurity mixing and a washing production process are required, and when a substrate material was not a plane, correspondence was not completed.

[0008] It was difficult for there to be a problem that processing cost is high, from that the manufacturing method by the electron and the ion beam takes a large-scale vacuum system, the point that an electron and the source of an ion beam are expensive, etc., and for working speed to also create a long scale late.

[0009] In the manufacturing method by laser ablation, the substrate material is processed directly. In laser ablation, big energy is required for removal processing of a metallic material, and control of a configuration is difficult. Glass and laser energy also with the big case of a ceramic material are required, and contraction projection processing is difficult productivity highly. Moreover, this is the processing method for a single material, and had the problem on which control of a reflection factor and quirk-like control are governed by the property of a single material. Moreover, in ablation, control of the processing depth per one exposure of a laser beam was difficult, and creation of the grid of the same configuration was difficult.

[0010] Moreover, the shape of a quirk to the field top which these manufacturing methods create optical elements, such as a diffraction grating and a scale, on planar structure materials, such as a glass substrate with usually high flatness, and has the

spherical surface was difficult. Moreover, when adding a diffraction grating to other materials, addition of a up to [ the field to rotate or the material which carries out elongation deformation ] was difficult.

[0011] Moreover, in order to control a signal by reflection, the material which carries out light absorption needed to be added to the rear face of a glass substrate, and in order that reflection might cut with the surface and the rear face in this case, there was a problem influenced of a substrate material. Moreover, since the selectivity of a substrate material was low, the expensive substrate material needed to be used, and the limit of the charge of a binder for pasting up the addition material and element to an element also had many problems.

[0012] It was made in order that this invention might solve the technical problem and defect of the above conventional technology, and it aims at offering the optical element which has the shape of a quirk created by the high-speed processing manufacture method and the above-mentioned manufacturing method of a diffraction grating or an optical element which were made perfect dry.

[0013]

[Means for Solving the Problem] An optical element manufacture method which starts claim 1 of this invention in order to realize said technical problem is characterized by to irradiate laser from a reflective film at polymeric materials which have a reflective film at least in a part and in which laser ablation processing is possible, and to create the shape of a diffraction lattice type of a reflective film with the laser ablation processing equipment which has optical system in which a projection exposure of a mask of a grid configuration is possible.

[0014] the optical element manufacture method concerning claim 2 of this invention be characterize by to irradiate laser from a reflective film, to move light or a substrate continuously to the material which have a reflective film at least in a part and in which laser ablation processing be possible, and to create the shape of a diffraction lattice type with the laser beam machining equipment which consist of means to which the location of arbitration may make carry out the parallel displacement of a means or a substrate which irradiate laser equipment and a laser beam in a location of arbitration.

[0015] An optical element manufacture method concerning claim 3 of this invention is characterized by using a reflective film material with high laser which outputs wavelength of an ultraviolet region in an optical element manufacture method according to claim 1 or 2 and permeability in this wavelength.

[0016] an optical element manufacture method concerning claim 4 of this invention -- claims 1-3 -- it is characterized by processing it, while laser equipment which energy of the transmitted light by reflective thin film can adjust in a field beyond a laser ablation threshold in an optical element manufacture method of a publication adjusts an output of a laser beam to either. [0017] An optical element manufacture method concerning claim 5 of this invention is characterized by having a scale-factor adjustment means and a parallel displacement means of a substrate in an optical element manufacture method according to claim 1 or 3.

[0018] An optical element manufacture method concerning claim 6 of this invention is characterized by having a means to move a work material which carried out a solid configuration in an optical element manufacture method according to claim 1 or 2, and this material in the direction of an optical axis.

[0019] An optical element manufacture method concerning claim 7 of this invention is characterized by using a material which formed a macromolecule thin film layer in which laser ablation processing is possible in the middle of a glass substrate and a reflective film in an optical element manufacture method according to claim 1 or 2.

[0020] A high polymer film concerning claim 8 of this invention is characterized by having the shape of a diffraction lattice type created by means according to claim 1 or 2.

[0021] The structure which added a high polymer film concerning claim 9 of this invention is characterized by adding and constituting said high polymer film according to claim 8 which adds said high polymer film according to claim 8 with adhesives, and is constituted or by which an adhesive layer or a glue line was prepared at least in a part.

[0022] At least a part is the spherical surface and the structure concerning claim 10 of this invention is characterized by adding and constituting a poly membrane which is equipped with the shape of a quirk created by means according to claim 1 or 2, or has the shape of an above-mentioned quirk.

[0023] At least a part is a solid configuration and the macromolecule structure concerning claim 11 of this invention is characterized by being created by means according to claim 6.

[0024] A high polymer film concerning claim 12 of this invention is a high polymer film according to claim 8, and is characterized by consisting of a material which distributed a material or an extinction material of a high absorption coefficient. Moreover, the structure concerning claim 13 of this invention is characterized by said poly membrane consisting of a material which it has [ material ] the shape of a diffraction lattice type according to claim 8, and distributed a material or an extinction material of a high absorption coefficient in the structure according to claim 10.

[0025] A high polymer film concerning claim 14 of this invention is a high polymer film according to claim 8, and is characterized by at least a part having the shape of a reflective film quirk on a transparent macromolecule. Moreover, the structure concerning claim 15 of this invention is the structure according to claim 10, and said poly membrane is characterized by at least a part having the shape of a reflective film quirk on a transparent macromolecule.

[0026] By the configuration concerning above this inventions, an irradiated laser beam penetrates a reflective film on a work material, and it reaches to polymeric materials, and according to the ablation operation by this laser beam, cleavage in a molecular level of polymeric materials sets, and a laser radiation portion disperses outside. Since material which disperses outside at this time also disperses a reflective film of that upper part in coincidence, processing of the exposure section whole region is performed.

[0027] Moreover, continuous configuration processing is made by carrying out the parallel displacement of the workpiece. [0028] When scanning a laser beam furthermore, processing of an optical element of a large area and a long picture is made by processing of a configuration of arbitration being made without a mask in order to carry out direct writing, and carrying out the parallel displacement of the workpiece to coincidence.

[0029] Moreover, polymeric materials have absorption strong against an ultraviolet region, and since there are many materials in which ablation processing with ultraviolet laser is possible, efficient processing is made by using laser of an ultraviolet region. Moreover, configuration formation from which a flute width differs on the same element is made by using a means to adjust laser reinforcement.

[0030] Moreover, in contraction projection processing by mask projection, selection of a processing scale factor is made by moving any two, a mask location, a projection lens, and the processing location, to coincidence, and the shape of a quirk from which a scale factor differs by this is formed.

[0031] Moreover, processing to a material which carried out a solid configuration is made by doubling a focus of a workpiece with a laser radiation focal location, and reflex-like generation of a up to [ the structure which carried out a spherical-surface top and a stage configuration ] is made.

[0032] Furthermore, a laser ablation layer is prepared in the middle, and processing of glass substrates with a reflective thin film, such as a metallic reflection film, is made by removing it by laser radiation. Moreover, when an ablation energy threshold of glass is sharply larger than a macromolecule, processing which does not do damage to a glass side by accommodation of processing energy is made.

[0033] Next, configuration deformation is easy for a high polymer film which has an optical function manufactured according to these manufacturing methods, and selection of cheap and a function becomes easy.

[0034] By a film which added a glue line as these polymeric materials being chosen, addition processing is immediately made after processing to other materials.

[0035] Moreover, optical functional addition to the spherical surface is made by optical functional addition into a material and addition of the above-mentioned film with a binder which have the spherical surface.

[0036] Moreover, processing to the structure which carried out a solid configuration is attained, and the structure by which a reflective film was controlled in three dimensions is created.

[0037] Moreover, by raising an absorption coefficient of polymeric materials, it approaches, a reflective film and an absorption band can be generated, and a gradual change of a reflection factor and a thin film optical element of a multi-gradation property are realized.

[0038] Moreover, a transparency mold optical element is realized by using a transparent macromolecule for reverse. [0039]

[Embodiment of the Invention] By the manufacture method by this invention, it consists of a production process which contraction-projects, or scans a laser beam and irradiates a space selection target at a substrate, a means to move a substrate to a three dimension, and polymeric materials which have a reflective film and in which ablation is possible. Furthermore, in order to raise the working characteristic of a macromolecule, it is desirable to consist of charges of a reflector with the high permeability in the wavelength of ultraviolet laser and this laser beam.

[0040] When a contraction projection scale factor adjusts a processing slot pitch, it consists of a mask, a lens, and any two parallel displacement means of the processing substrate location. Especially a work material forms the thin film of the polymeric materials in which ablation is possible between a substrate and a reflective film, when it consists of polymeric materials which added the reflective thin film and forms a reflective film especially on a glass substrate.

[0041] moreover, the configuration in which the optical element by this invention has the shape of a quirk of a reflective film -- or [ deformable high polymer film, the structure which has the spherical surface, the macromolecule structure which carried out the solid configuration, the structure which added the above-mentioned film, and \*\*\*\*\*\*\*\* ] -- from -- it is constituted and, as for polymeric materials, it is desirable to consist of a transparent material, a light absorption material, or a charge of light absorption material add-in material, and when pasting up an element on the structure, the material with which the charge of a binder was added beforehand is desirable.

[0042] The gestalt of operation of this invention is explained below.

(The 1st operation gestalt) The 1st operation gestalt of this invention is shown in <u>drawing 1</u>. Being transmitted in total reflection mirror 2 grade, by the shaping optical system 3, it is reinforcement-adjusted, and is equalized, and the laser beam oscillated from laser equipment 1 in this drawing is irradiated by the mask 4. With the projection lens 5, the intensity distribution of a mask are projected on the workpiece 6 with a reflective film. It is fixed on the stage 7 which can be adjusted in the direction of an optical axis, and if the workpiece 6 with a reflective film has necessity, it will consist of a device which moves on a stage 7 and creates a pattern continuously.

[0043] The mimetic diagram of the manufacturing method of the optical element by this invention is shown in  $\underline{drawing\ 2}$ . About 500-1000A of reflective films M2 is added on the film M1 in which ablation is possible. Reflective film N2 can create the poly membrane containing the method of adding metal membranes, such as Cr and aluminum, by vacuum evaporationo or the spatter, coloring matter, etc. on a spin coat etc. A laser beam M3 is irradiated at this film M1 with a reflective film. A part of irradiated laser beam M3 penetrates the reflective film M2, and it is irradiated by polymeric materials M1. The reflective film M2 is removed with the ablation of this macromolecule, and a diffraction grating M4 is formed.

[0044] (The 2nd operation gestalt) The 2nd operation gestalt of this invention is shown in <u>drawing 3</u>. It is transmitted through a total reflection mirror 13 or orifice 14 grade, and is condensed with a condenser lens 15, and the laser beam 12 oscillated

from laser equipment 1 is irradiated by the sample. A laser beam is scanned by a galvanomirror 16 and the migration stage 17 on a work material 18. A work material 18 consists of a configuration of said <u>drawing 2</u>, and is processed by the same principle. A laser beam can adjust changing-laser reinforcement processing width of face, and the same operation is possible for it even if it forms beam attenuator in equipment.

[0045] (The 3rd operation gestalt) The 3rd operation gestalt of this invention is shown in drawing 4. Being transmitted in total reflection mirror 2 grade, by the shaping optical system 3, it is reinforcement-adjusted, and is equalized, and the laser beam oscillated from laser equipment 1 is irradiated by the mask 4. A mask is installed on the migration stage 25 and is movable to the direction of an optical axis. Moreover, it has the device in which a mask is rotated by the case, and the device in which masks are exchanged. The image of a mask is irradiated by the work material 8 surface fixed on the migration stage 7 through the projection lens 5. This mask migration stage 25 and the migration stage 7 are controlled by the computer 10 through the stage controller 9. Migration, the number of laser radiation, and laser radiation reinforcement of a stage are controlled by the computer to coincidence. Configuration processing from which a scale factor differs is attained from one mask by this, and various configuration processings are attained by performing mask exchange and laser adjustment on the strength to coincidence.

[0046] (The 4th operation gestalt) The 4th operation gestalt of the glass substrate top diffraction-grating creating method is shown in <u>drawing 5</u>. A poly membrane N2 is added on a glass substrate N1. If a poly membrane N2 sets to about 0.1 micrometers or less, it can exfoliate the reflective film N3 and a poly membrane N2 in coincidence in one laser beam exposure of low energy comparatively. moreover, the thing for which laser reinforcement is irradiated below at the laser ablation threshold of glass -- the glass surface N1 -- effect \*\*\*\*\*\* -- creation of a highly precise reflective film configuration be / nothings ] can be performed. A material can use not only a macromolecule nature resist but the photo-curing and heat-curing mold resin, and the various macromolecules which are used for exposure.

[0047] (The 5th operation gestalt) The manufacturing method of an optical element and optical element which are the 5th operation gestalt by this invention are shown in <u>drawing 6</u>. The reflective films P2, such as Cr and aluminum, are added on the macromolecule optical material P1 which has the spherical surfaces, such as an optical lens. A laser beam P3 is alternatively irradiated from on the reflective film of this material. If the shape of a quirk of the reflective film P2 generates by this and light is irradiated at this element, a part will be reflected and a part will penetrate. The reflected light diffuses at this time and the transmitted light is condensed. Thus, the processed optical element P4 has an optical function.

[0048] (The 6th operation gestalt) The optical element which has the spherical surface by spherical-surface processing which is the 6th operation gestalt by this invention in drawing 7 is shown. On the structure R1 which the shape of a cylinder rotates, the macromolecule thin film R2 in which ablation is possible is added, and the reflective film R3 is added further. A laser beam R4 is irradiated partially at this, and a reflective film pattern is formed according to the above-mentioned ablation operation. By carrying out the sequential exposure of the laser beam R4, rotating this body of revolution R1, a reflective film pattern is formed in the body-of-revolution R1 surface, and the surface scale R5 is created. Since this scale is formed in the surface, it becomes available to surface position control and speed control. This creates a scale and adding it to body of revolution can also attain.

[0049] (The 7th operation gestalt) The manufactured optical element is indicated to be an example of reflective pattern manufacture to the spacial configuration object which is the 7th operation gestalt by this invention to drawing 8. The polymeric materials in which ablation processing is possible are processed in three dimensions, and it considers as the spacial configuration object S1. Machining, the Mitsuzo form, ablation processing, etc. can be used for solid processing. The reflective film S2 is added to this material by the spatter, vacuum evaporationo, etc., and a laser beam S3 is irradiated at a space selection target. Only the plane section of drawing 8 is processed according to the above-mentioned laser ablation operation. Thereby, light penetrates the plane section and a slant face serves as optical element S4 to reflect. If the signal light S5 is irradiated at this element, it will be reflected partially and light will function as a light reflex element as shown in drawing.

[0050] (The 8th operation gestalt) The optical element which includes in <u>drawing 9</u> the charge of an absorber which is the 8th operation gestalt by this invention is shown. The poly membrane T1 which controlled the absorption coefficient is taken as the structure where put on a multistage story, or control variance, and a reflection factor changes with thickness. The reflective film T2 is added on this poly membrane T1, and laser beam T3 is irradiated there. Laser beam T3 controls reinforcement, changes the processing depth by changing an exposure, and is taken as structure T four shown in <u>drawing 9</u>. If light is irradiated at such structure T four, as shown in <u>drawing 10</u>, signal strength will change with locations. The function as an optical element which generates a gradual signal by this is achieved.

[0051] (The 9th operation gestalt) One example of the optical element using the transparence macromolecule which is the 9th operation gestalt by this invention is shown in <u>drawing 11</u>. Patterning is carried out to the configuration which shows the reflective film V2 on the macromolecule thin film V1 in drawing (A) by the above-mentioned technique. It is shown in (B) and (C) still more nearly similarly, and configuration processing is carried out and an optical element V3 is created. Since these are transparent and it is also possible to make it very thin, pattern processing of a complicated configuration in piles as shown in drawing is attained in these. In this case, (A), (B), and (C) are possible also for considering as the same configuration, and since it is transparent, signal processing of a transparency mold of them also becomes possible. [0052]

[Effect of the Invention] As explained in full detail above, according to this invention, a part of irradiated laser beam reaches to polymeric materials by using the reflective film on a work material as a thin film. According to the ablation operation by

this laser beam, the cleavage in the molecular level of polymeric materials sets, and a laser radiation portion disperses outside. Since the material which disperses outside at this time also disperses the reflective film of that upper part in coincidence, processing of the exposure section whole region is performed.

[0053] By making reflective film thickness thin here, processing of a reflective film is possible at a laser beam child piece, and since laser radiation time amount can be shortened at several or less nanoseconds, very high-speed processing is attained. Moreover, since reflection is controlled by removing a reflective film, it is not necessary to control the processing configuration of the depth direction correctly, and many materials can be used as a reflective film and a substrate material. [0054] In contraction projection processing, the configuration of a mask is reduced and the location of a request of a substrate glares. In such contraction projection, since it can carry out by putting the configuration of a large area in block, productivity becomes high very much.

[0055] Moreover, by carrying out the parallel displacement of the workpiece, it is possible to carry out configuration processing continuously, and creation of a long scale etc. can be performed easily. Moreover, mask shape can be chosen, masks are exchanged and not only the shape of a quirk but the shape of a various reflex can be created.

[0056] When scanning a laser beam furthermore, since direct writing is carried out, it is possible to process the configuration of arbitration without a mask, and since a laser beam is condensed and used, also when a laser output is low, it is available, and can be processed into a high speed by using repeat laser, a galvanomirror, etc. Moreover, it becomes processible [ the optical element of a large area and a long picture ] by carrying out the parallel displacement of the workpiece to coincidence. [0057] Usually, polymeric materials have absorption strong against an ultraviolet region, and there are many materials in which ablation processing with ultraviolet laser is possible. For the reason, efficient processing is attained by using the laser of an ultraviolet region. Under the present circumstances, since the reflection property in a visible region is used from infrared rays, when using ultraviolet laser, it is desirable [ the charge of a reflector ] to use a material with high permeability in that wavelength region.

[0058] Moreover, film processing width of face changes with laser energy intensity in thin film processing by assistance of such ablation. Therefore, by using a means to adjust laser reinforcement, formation becomes possible easily about the configuration from which a flute width differs on the same element.

[0059] Moreover, in contraction projection processing by mask projection, it is possible to choose a processing scale factor as arbitration by moving any two, a mask location, a projection lens, and the processing location, to coincidence, and formation of it is easily attained in the shape of a quirk from which a scale factor differs by this.

[0060] Moreover, it becomes processible to the material which carried out the solid configuration by doubling the focus of a workpiece with a laser radiation focal location, and reflex-like generation of a up to [ the structure which carried out the spherical-surface top and the stage configuration ] also becomes possible.

[0061] In metal thin film processing on a glass substrate, generally by laser ablation, processing becomes possible processing glass substrates with a reflective thin film, such as a difficult metallic reflection film, into a high speed by low energy ] by preparing a laser ablation layer in the middle and removing it. Moreover, the cross-section configuration of this removed film turns into a good configuration which is not acquired in thermoforming, such as laser trimming.

[0062] Moreover, the ablation energy threshold of glass is sharply larger than a macromolecule in many cases, and becomes processible [ which does not do damage to a glass side ] by processing it with this energy. There is also a cleaning effect which removes the organic substance which adhered to coincidence in the glass side at this time.

[0063] Next, it is cheap, and the high polymer film which has the optical function manufactured according to these manufacturing methods has the feature that brittleness is low, and selection of a function is [ the selectivity of a material is high and ] configuration deformation is possible and possible for it.

[0064] By choosing the film which added the glue line as these polymeric materials, it is possible to add to other materials immediately after processing, and the optical function to a structure agent can be added. Especially the adhesives of a macromolecule have wide selection width of face, and are easy to choose bond strength, a thickness heat characteristic, etc. [0065] Moreover, the optical functional addition to the difficult spherical surface becomes easy by the optical functional addition into a material and the addition of the above-mentioned film with a binder which have the spherical surface. Thereby, the mask to a lens top, encoder ability creation of a up to [ an optical branching element and the spherical surface ], etc. are attained.

[0066] Moreover, processing to the structure which carried out the solid configuration is also possible, and the structure by which the reflective film was controlled in three dimensions can be created. Since such the structure can control an optical function spatially, it becomes possible [ adding an optical function to some of reflective branching elements, micro machines and sensors ].

[0067] Moreover, a reflective film and an absorption band can approach and generate by raising the absorption coefficient of polymeric materials, a reflection factor is changed gradually or creation of the thin film optical element in which the signal of many gradation is formed is attained. Moreover, by making light absorb in a macromolecule layer, it is N/A of the element of a reflective mold. It can raise.

[0068] Moreover, the use as the same transparency mold optical element as glass is attained by using a transparent macromolecule for reverse, and it becomes possible in these elements to perform superposition and various signal formation.

[Translation done.]